

## investiamo nel vostro futuro

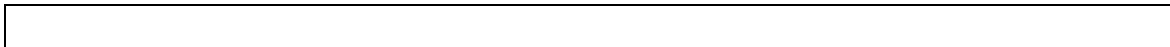
### AVVISO PER UN'INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA "DOMUS – Energia" – PON03PE\_00050\_2- CUP C38C14000040005

Il Dipartimento DIIES dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, intende avviare un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse inerenti la partecipazione ad una procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nell'ambito del Progetto di ricerca "DOMUS – Energia" - PON03PE\_00050\_2- CUP C38C14000040005, di un servizio di fabbricazione di microchip con funzioni fotoniche.

<b>Fabbricazione microchip con funzioni fotoniche</b>
<b>DESCRIZIONE</b> Fabbricazione di switch fotonici a microchip in silicio mediante tecnologie compatibili con la CMOS
<b>CARATTERISTICHE</b> Fabbricazione di un microchip in silicio (die) che preveda almeno l'integrazione dei seguenti blocchi funzionali fotonici: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ n. 3 switch elettro-ottici 1x2</li><li>▪ n. 1 switch elettro-ottico 1x4</li><li>▪ n. 2 strutture test passive</li></ul> <p>Possono essere previste differenti geometrie per ciascuna tipologia di switch al fine di tenere in considerazione eventuali variazioni di processo durante la fase di realizzazione.</p> <p>Inoltre a bordo del microchip devono essere previsti almeno n. 2 fotorivelatori (ad esempio in SiGe) per il monitoraggio della radiazione ottica all'uscita degli switch al fine di permettere un controllo diretto del segnale elettrico da applicare allo switch, e dispositivi di accoppiamento fibre ottiche-microchip (taper, gratings...).</p> <p>I processi tecnologici di fabbricazione dei dispositivi fotonici devono essere compatibili con la tecnologia elettronica complementary metal-oxide semiconductor (CMOS). Le guide ottiche devono avere larghezza non superiore ad 1 micron.</p> <p>Devono essere forniti 10 microchip identici. Almeno un microchip deve essere fornito con packaging che includa fibre ottiche singolo modo di ingresso ed uscita.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lunghezza d'onda di lavoro: 1550±10 nm</li><li>▪ Larghezza di banda: 0.5 nm</li><li>▪ Perdite di inserzione: &lt; 3 dB</li><li>▪ Crosstalk: &lt; 20 dB</li><li>▪ Tempo di commutazione: &lt; 1 ms</li><li>▪ Polarizzazione: TE oppure indipendente dalla polarizzazione</li><li>▪ Dimensioni massime del chip 3 mm x 3 mm</li></ul>



investiamo nel vostro futuro



**Importo a base d'asta: € 16.000,00 oltre IVA.**

### **Criterio di aggiudicazione**

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del D.Lgs 163/2006.

### **Soggetti ammessi**

E' ammessa la partecipazione alla suddetta procedura dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### **Requisiti di partecipazione**

- a) esenzione dalle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) insussistenza misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- d) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la normativa italiana o quella del paese di residenza.

Per il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere inviata dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

### **Interesse a Partecipare**

I soggetti interessati possono presentare le proprie adesioni, in apposito plico sigillato recante esternamente la seguente dicitura "Manifestazione d'interesse per la partecipazione a una procedura d'acquisizione in economia di un servizio di fabbricazione di microchip con funzioni fotoniche" entro il 10/03/2016, per posta, tramite corriere o anche brevi manu, al Dipartimento DIIES Via Graziella, località Feo di Vito (Presso ex Facoltà di Ingegneria). I candidati verranno quindi contattati dal Dipartimento DIIES che fornirà loro i dettagli per accedere alla successiva fase di presentazione delle offerte e di valutazione.

### **Precisazioni**

La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse dei soggetti aderenti all'iniziativa non vincolano in alcun modo il Dipartimento DIIES a procedere all'invito per affidamento. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico.

### **Ulteriori richieste di chiarimenti**

Per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento si prega di contattare l'indirizzo [diies@unirc.it](mailto:diies@unirc.it).

Responsabile del procedimento  
Dr Santo Santacaterina

Firmato  
Il Direttore  
Prof. Giacomo Messina